

Si基板表面の粗さ評価



<分析手法>: 非接触三次元測定装置

測定対象を平面内で移動させながらレーザー光(径: $1.0\mu\text{m}$)を照射し、表面で反射される光を検出することで、三次元形状情報を得る装置です。

最大で150mm \square 、高さ10mmの試料に対して、高さ方向分解能: 10nmでの高精度測定が可能です。

<試料・結果>

表面処理の違いによるSi基板表面の表面粗さの差異を評価しました。

ある条件で表面処理を施すことにより、表面粗さ(算術平均粗さ: R_a)が約1.3倍に大きくなることを確認しました。

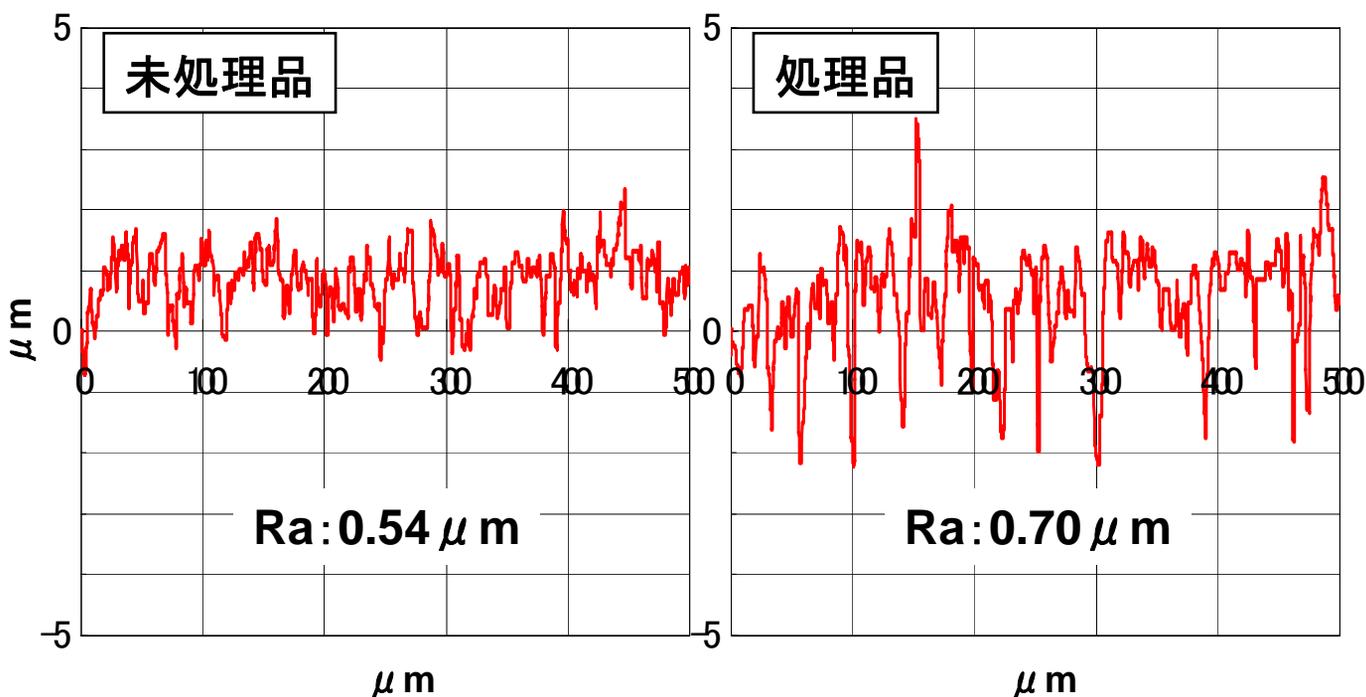


図 未処理品・処理品の断面プロフィールと R_a